

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **TQFP24-144PIN**

JEITA Package name; **P-TQFP144-1616-0.40**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.67** [g] ※1

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	15	シリコン	7440-21-3	15.4	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00003	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.0001	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0003	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.0001	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00003	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0003	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0003	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0005	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00003	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.3	ポリイミド	-	0.31	1000000	保護膜 ※4
	ダイアタッチ材	4.0	銀	7440-22-4	2.6	640000	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.82	205000	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.32	80000	接着剤
			無機粉末	-	0.19	48000	添加物
			ビスマス化合物	-	0.10	27000	イオントラップ
	端子メッキ	13.7	錫	7440-31-5	13.4	980000	はんだ
	リードフレーム	196	ビスマス	7440-69-9	0.28	20000	はんだ
			銅	7440-50-8	186	945000	導体材
			銀	7440-22-4	0.98	5000	インナーリードメッキ
			その他成分 ※5	-	9.8	50000	添加剤
	ボンディングワイヤー	3.2	金	7440-57-5	3.2	1000000	導体材
	モールド樹脂	437	エポキシ樹脂	-	21.8	50000	主成分
			三酸化アンチモン	1309-64-4	1.7	4000	難燃助剤
			ブロム化エポキシ樹脂	-	3.9	9000	樹脂難燃剤
			シリカ	60676-86-0/-	353	807000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	6.6	15000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	26.2	60000	硬化剤
			有機リン化合物	-	2.2	5000	硬化促進剤
			その他	-	21.80	50000	添加剤

化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。
従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。
- ※5 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。